

【11】證書號數： I230449

【45】公告日： 中華民國 94 (2005) 年 04 月 01 日

【51】Int. Cl.⁷: H01L23/36

發明

全 3 頁

【54】名稱： 半導體晶片之高散熱微小封裝體

【21】申請案號： 091103722

【22】申請日期： 中華民國 91 (2002) 年 02 月 26 日

【72】發明人：

謝文樂

楊家銘

梁淑芬

謝岩樹

周淑敏

曾春龍

YANG, CHIA MING

LIANG SHU FEN

HSIEH YEN SHU

CHOU SHU MIN

TSENG, CHUN LUNG

【71】申請人：

華泰電子股份有限公司

ORIENT SEMICONDUCTOR
ELECTRONICS, LIMITED

高雄市楠梓區楠梓加工出口
區中三街9號

【74】代理人：花瑞銘 先生

1

2

[57]申請專利範圍：

一種半導體晶片之高散熱微小封裝體，其包含：

一導線架，該導線架以蝕刻製程作出一凹入之晶片座平台，在該平台四周設為鏤空之鏤空槽孔僅留有數片支撐帶連接至導線架主體；

一基板，該基板可應用於高密度線路之製作，以達到高腳數的需求，並將該腳位製作於相對於導線架之鏤空槽孔位置，以接合金線；

一晶片，該晶片以接合劑正向接合於導線架之晶片座上，並以打線技術將金線打在晶片腳墊與基板上之預留電性接合腳位上，以達到其功能輸出的目的，且該晶片運作時產生之熱量可藉由晶片座經支撐帶傳導到導線架的其他區域散發，達到高散熱之功能；

10. 根據上述結構將導線架與基板接合後，將晶片接合於導線架之晶片座

(2)

3

4

上，並以打線技術將晶片腳墊與基板間以金線導通，最後以封膠填於鑲空槽孔並包覆金線與導線架表面區域一部份者。

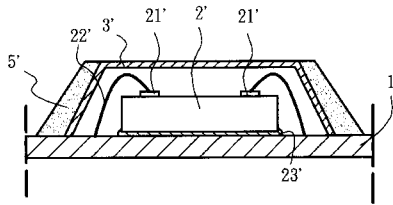
圖式簡單說明：

第一圖係習用之使用散熱片封裝體之結構示意圖。

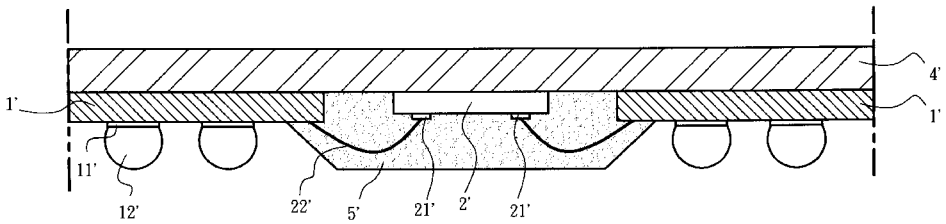
第二圖係習用之另一實施例結構示意圖。

第三圖係本創作之導線架結構示意圖。

5. 第四圖係本創作封裝件之結構示意圖。



第一圖



第二圖

